

Model	System Name	Material	Wafer Size	Unit	Capacity	Price	Lead Time	Notes
NT02	PZT Coater	PZT Coating	NT02_01	6" Wafer	매	100,000	x	40,000 (PZT, SiO2 Coating)
NE01	Deep Reactive Ion Etcher(DRIE)	외 고출력형 식각	NE01_01	4" Wafer	매	120,000	-	150,000 (Si Deep Etching) 깊이 50um 추가 50um Etching 시 100,000원/50um 추가
NE02	PZT Etcher	PbZrTiO3 입안제 간식 식각	NE02_01	4" Wafer	매	80,000	-	50,000 (PPPC Coating) Etching Time 2분 5분
DP01	Spin Coater with Glove Box	고분자 유기 반도체 물질 도포	DP01_01		매	30,000	-	40,000
DP03	Display Photo Base System							
DP03-1	Glass Cleaner System	Glass 세정, 예칭 시스템	DP03-1_01		회	20,000	-	30,000
DP03-2	Spin Developer	200~2000 사이즈 이하의 기판 세척 및 현상	DP03-2_01		매	20,000	-	30,000
DT01	Ink Jet Printing System	유기반도체물질 전극패턴형성	DT01_01		매	30,000	-	40,000
DT02	OMBD & Metal Evaporation System							
DT02-1	OMBD & Thermal Evaporator	OTFT 제작용 유기 증착	DT02-1_01		매	100,000	-	150,000
DT02-2	Metal Evaporator	OTFT 제작용 금속 증착	DT02-2_01		매	100,000	-	150,000
DT03	OLED Evaporation System							
DT03-1	OLED Evaporator - I	OLED 제작용 유기 증착	DT03-1_01		1 layer	160,000	-	190,000
DT03-2	OLED Evaporator - II	Metal Thermal Evaporation	DT03-2_01		1 layer	160,000	-	190,000
DT03-4	Sputter		DT03-4_01		매	160,000	-	190,000
DT04	PECVD System	플라즈마 화학 기상 증착기	DT04_01		1 layer	120,000	-	150,000
DM01	OLED Probe Station with Glove Box							
DM01-1	OLED Probe Station	OLED소자의 I-V, C-V 특성 측정	DM01-1_01		hr	40,000	-	70,000
DM01-2	Glove Box	우물 및 산소에 민감한 유기물반도체의 전극제 특성평가	DM01-2_01		hr	40,000	-	70,000
DM01-3	I-V Meter	유기반도체의 전극제 특성측정	DM01-3_01		hr	40,000	-	70,000
DM01-4	Low Temperature Probatation System	유기반도체의 저온 특성측정	DM01-4_01		hr	40,000	-	70,000
SN01-2	UV-Vis/NIR Spectrophotometer (CMT)	UV/Vis/NIR 측정	SN01-2_01		시료당, 매	12,000	-	16,000
MM01	High Resolution FE-SEM	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS	MM01_01		HR	50,000	-	80,000
MM02	Focused Ion Beam System (Sum)	3차원 가공 및 구조, 표면의 입체적 분석, TEM 시편제작	MM02_01		SEM/ FIB	50,000	-	50,000
MM03-1	Focused Ion Beam / EBSD	3차원 가공 및 구조, 표면의 입체적 분석	MM03_01		FIB/ EBSD	200,000	-	200,000
MM03-3	Nano Indenter	기계적 분석	MM03_03		HR	200,000	-	200,000
MM04	HR (S)TEM - 1.2130M with Cs Corrected STEM	투과전자현미경에 의한 나노구조/성질분석 TEM/ STEM/ EELS/ EDX/ HR/ Cs-corrected	MM04_01		HR	x	-	250,000
MM05	HR-STEM - 2220FS with Image Cs-corrected	투과전자현미경 나노구조/성질 분석 TEM/HR/EDX/SAED/EF-TEM/EELS	MM05_01		HR	x	-	250,000
MM06	3 Dimensional Atom Probe	3차원원자정량분석장치용 절연 반도체, LED, 나노소재 위치정보 및 성분분석	MM06_01		시료당 (5hr 기준)	x	-	1,200,000
MM07	SPM System	표면분석	MM07_01		HR	x	-	60,000
MM07-3	SPM System (SLM)	원자힘현미경	MM07_03		HR	x	-	60,000
MM08	Multi-mode STM & AFM	나노소재 구조확인 및 분석, 물성분석	MM08_01		HR	50,000	x	60,000
MM09	Secondary Ion Mass Spectrometry	역방향 이온 질량분석	MM09_01		시료당 (3시간 기준)	x	-	120,000
MM10	Dual Beam FIB (Focused Ion Beam)	3차원 가공 및 구조, 표면의 입체적 분석	MM10_01		HR	200,000	-	200,000
MC01	Magnetic Property Measurement System	나노소재 극자성 자기특성측정	MC01_01		HR	x	-	25,000
MC02	Low Temp Probe Station	나노소재의 극저온 특성측정장치	MC02_01		HR	15,000	-	20,000
M501	Sample Preparation System (SI-TEM)	Cutting/Grinding/Polish(Gentle)	M501_01		시료당 (4시간)	x	-	100,000
M501	Sample Preparation System (Replica)	MIB/ Ion Beam Thinner/Steel	M501_02		시료당 (3시간)	x	-	80,000
M501	Sample Preparation System (EBSD/Steel-TEM)		M501_03		시료당 (4시간)	x	-	80,000
M501-1	Cutting/Grinding/Polishing System	절단연마시스템	M501-1_01		TEM/시료	x	-	60,000
M501-1	Cutting/Grinding/Polishing System	절단연마시스템	M501-1_02		TEM/시료	x	-	10,000
M501-1	Cutting/Grinding/Polishing System	절단연마시스템	M501-1_03		시료당 4hr	x	-	100,000
M501-1	Cutting/Grinding/Polishing System	절단연마시스템	M501-1_04		시료당 4hr	x	-	80,000
M501-1	Cutting/Grinding/Polishing System	절단연마시스템	M501-1_05		시료당 2hr	20,000	-	30,000
M501-1	Cutting/Grinding/Polishing System	절단연마시스템	M501-1_06		시료당 4hr	30,000	-	40,000
M501-1	Cutting/Grinding/Polishing System	절단연마시스템	M501-1_07		시료당 4hr	50,000	-	80,000
M501-1	Cutting/Grinding/Polishing System	절단연마시스템	M501-1_08		Electro-polishing	10,000	-	20,000
M501-2	Gentle Mill	여유균이온윤리나	M501-2_01		15min	20,000	-	20,000
M501-3	Ion Beam Thinner(IPS)	여유균이온연마	M501-3_01		15min	10,000	-	10,000
M501-3	Ion Beam Thinner(IPS)	여유균이온연마	M501-3_02		회/매	10,000	-	10,000
M501-4	Carbon Coater	카본코터	M501-4_01		30min	x	-	10,000
M501-4	Carbon Coater	카본코터	M501-4_02		시료당 4hr 기준(4hr)	120,000	-	120,000
M501-4	Carbon Coater	카본코터	M501-4_02		시료당 3hr 기준(2hr)	100,000	-	100,000

-반도체 장비- 참고	1. 기존시판 크기 이외의 Wafer의 경우, 추가 비용 발생가능
	2. 추가되는 가공/가공재료 계산하여 추가
	3. Wafer 사용 시 크기별 가격은 8인치(40,000원), 6인치(30,000원), 4인치(20,000원)
	4. 장비 운영을 위한 운영서비스 외, 연구원의 기술인력, TCG 설계 등에 대한 기술서비스의료를 50,000원/HR
-기계 장비- 참고	5. 24해 이상의 대량 출항할 경우, 유류 별도 협의 가능
	6. 긴급 서비스 및 기밀이 요구되는 서비스 등 특수한 경우에는 50%이내에서 추가료를 적용

1. 제조의 별도
2. 기존 Slayer 이상
3. Slayer 미만 시 Slayer 금액에 맞추
4. Encapsulation
-기공 채워 기준 : 100,000
4. OLED/나노 구조 및
-10,000원